

证券代码：874223

证券简称：地拓精科

主办券商：天风证券

大连地拓精密科技股份有限公司 关于 2025 年度拟向银行申请授信额度公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

为满足公司日常的业务发展的需要，公司拟向金融机构申请授信额度，申请总额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在本次授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额根据资金的实际需求来确定。

上述额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定，具体担保方式等以公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。同时授权董事长马跃签署与上述授信及实际融资业务有关的各类法律文件并办理有关事宜，上述额度及授权期限自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

二、表决和审议情况

2025 年 4 月 8 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年拟向银行综合授信额度的议案》

会议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、 申请授信的必要性以及对公司的影响

公司本次申请银行授信额度是为保证公司资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，会对公司日常经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、 备查文件

经与会董事签字的公司《第一届董事会第十次会议决议》

大连地拓精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日